

AMPMODU | AMPMODU IV/V

TE 内部编号 1-5147733-2

PCB Mount Receptacle, Horizontal / Right Angle, Board-to-Board,
13 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Tin, Surface Mount, Signal,
AMPMODU IV/V

[在 TE 官网查看>](#)[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [PCB 板端连接器及母端](#)

连接器系统: 板对板

位数: 13

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 水平, 直角

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准, 高
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

可堆叠	是
位数	13
行数	1
PCB 安装方向	水平, 直角

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	333 VAC

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
--------	-----------------



PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 7.62 μm
端子布局	直插式
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 7.62 μm [150 – 300 μin]
端子形状和构造	短点
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	2 A
端接特性	
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
壳体特性	
外壳材料	聚酯 - GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
堆叠高度	.32 mm[8.13 in]
连接器高度	3.48 mm[.137 in]
PCB 厚度（建议）	1.02 mm[.04 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]
使用环境	
壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 125 $^{\circ}\text{C}$ [-85 – 257 $^{\circ}\text{F}$]
操作/应用	
焊接工艺特性	板支座



电路应用

Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容

CSA LR7189, UL E28476

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量

1

封装方法

包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



客户还购买了





文档

产品图纸

13 MODII HORZ SR SFMNT SN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5147733-2_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5147733-2_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5147733-2_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5

英文版本